公司代码:688019 公司简称:安集科技

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二、风险因素。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过的利润分配预案为:公司拟以实施2020年度利润分派权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为53,108,380股,以此计算合计拟派发现金红利总额为15,932,514.00元(含税),占母公司当年实现可分配利润比例的11.01%,占公司合并报表归属上市公司股东净利润的10.35%,剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配方案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	安集科技	688019	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和证券事务代表

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨逊	冯倩
办公地址	上海市浦东新区碧波路889号1座1-3楼	上海市浦东新区碧波路889号1座1-3楼
电话	021-20693201	021-20693201
电子信箱	IR@anjimicro.com	IR@anjimicro.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和抛光后去除剂的垄断,实现了进口替代,使中国在该领域拥有了自主供应能力。

在化学机械抛光液板块,公司积极加强并全面对接全品类产品线的布局,旨在为客户提供完整的一站式解决方案。一方面,公司化学机械抛光液包括硅抛光液、钨抛光液(STI)抛光液、介质层抛光液、铝抛光液、铜以及铜阻挡层抛光液、硅通孔(TSV)抛光液和基于氧化铈磨料的抛光液等系列产品。另一方面,抛光后清洗液是化学机械抛光工艺过程中处理颗粒污染物的关键材料,包括铜制程抛光后清洗液、钨制程抛光后清洗液以及抛光垫清洗液等系列产品。同时,公司还基于化学机械抛光液技术和产品平台,支持客户对于不同制程的需求,定制研发用于新技术新工艺的化学机械抛光液。公司产品已供应国内外多家逻辑芯片和存储芯片制造商,并成为国内主流的抛光液供应商。公司化学机械抛光液已成功用于130-14nm逻辑芯片工艺、存储芯片工艺和三维集成工艺,10-7nm技术节点产品正在研发中。

在光刻胶去除板块,公司专注聚焦于全品类光刻胶去除不方点最关并提供相应的产品和解决方案。根据光刻胶下游应用领域不同,公司光刻胶去除剂包括集成电路制造用、扁平显示封装用、LED/OLED用等系列产品。

(二) 主要经营模式

1.采购模式

公司制定了《采购管理程序》和采购管理内部控制流程,并制定了《采购流程》、《供应商管理流程》、《供应灾难恢复程序》等标准作业程序。

(1)一般采购流程

以原、辅材料和包装材料为例,公司的一般采购主要流程如下:

①技术研发部根出材料开发需求,采购部负责开发供应商,并由供应商管理小组负责材料评估、供应商认证、审核、导入及批准为公司合格供应商,采购部负责建立并维护《合格供应商目录》。公司供应商管理小组由采购部、技术研发部、质量部、生产运营部等部门人员组成。

②需求部门提出采购申请,并按照公司审批权限得到合适的批准后提交采购部,采购部负责管理订单执行,质量部负责采购来料检验管理,仓库负责采购入库管理。

③采购部根据采购合同/订单,获取发票,并整理入库及验收等付款凭证提交财务部申请付款并得到审批。

④财务部根据采购合同/订单约定负责采购付款管理。

(2)外协采购流程

报告期内,公司产品LED/OLED用光刻胶去除剂存在委托外协供应商生产的情形,即公司与外协供应商签订协议,外协供应商严格按照公司提供的工艺文件、技术标准采组织生产,进行质量管理控制。公司所有的产品配方、生产工艺、任何发明、设计、技术信息、技术、专有技术或者由公司依协议授权外协供应商使用的商标、商业秘密及其他知识产权属于公司所有并独有。公司的外协采购主要流程如下:

①生产运营部根据月度销售预测生成外协采购申请单;

②采购部根据外协采购申请单下订单;

③外协供应商按订单要求安排生产;

④财务部每月末进行外协采购成本核算。

2.研发模式

公司始终围绕自身的核心技术,以自主研发为主,形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制。同时,公司与高校、客户等外部单位建立了良好的合作关系,积极开展多层次、多方式的合作研发。公司的研发目标一方面表现随行业发展的技术发展路线图,研发适应产业需求的产品平台;另一方面表基于下游客户的需求,针对性研发满足客户需求的产品。由于从开始研发到实现规模化销售需要较长的时间,公司与技术新先的客户合作开发,有助于了解客户需求并为其开发创新性的解决方案。

公司制定了《研发管理制度》,并建立了研发管理内部控制流程,涵盖研发计划、研发立项、研发过程跟进和费用核算管理、专利申请和取得等环节。公司产品研发及产业化的一般路径主要包括项目论证、研发Alpha测试、Beta送样试生产、商业化(规模化生产)、持续改进等五个阶段。

3.生产模式

公司在产品设计及研发前期,即投入大量资源与下游客户进行技术、品质、性能交流。当产品通过客户评价和测试后,销售部会根据客户的产品订单及对于客户使用需求的预测制定滚动出货预期,生产运营部根据年度/月度生产计划,滚动出货预期和库存情况制订具体的生产计划,安排所存、具体而言,生产运营部每年组织各相关部门,根据排产计划编制年度生产计划及月度生产计划。生产运营部会定期进行集体评审,根据每月存货存量、滚动出货预测制定具体的生产计划,以确保生产计划满足销售合同以及生产产能的要求;生产运营部组织各相关部门,各产品线负责人召开生产调度会,对生产计划的执行情况进行评审,以确保充分沟通可能影响生产计划变更的各种因素,及时调整生产计划(如及时关闭停工订单),以确保计划调整的及时性及有效性。

公司已经掌握了化学机械抛光液和光刻胶去除剂生产中的核心技术,通过合理调配机器设备和生产资源相协生产。

4.销售模式

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域,销售主要采用直接面对终端客户的直销模式。公司在开拓新客户或在原有客户推广新产品时,首先要根据客户的需求进行认证测试,包括产品样品测试、试用性测试、批量性等多方面测试,认证测试周期一般较长。公司在通过下游客户认证后,客户直接向公司下达采购订单,公司按要求直接供货产发货。同时,公司根据销售合同条款,以及时间、新加坡等国家通关政策,以及卫生和社会工作业等。毕马威华振2019年本公司同行业上市公司的比较分析如下:

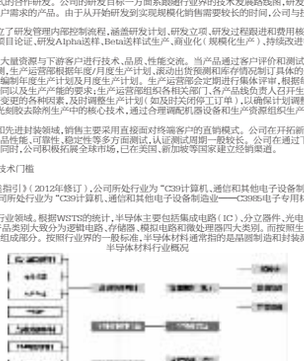
半导体材料行业概况

(1)行业定位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类标准,公司所处行业为半导体材料行业。

半导体材料属于半导体行业的细分行业领域,根据WSTS的统计,半导体主要包括集成电路(IC)、分立器件、光电器件和传感器四大类,这其中集成电路市场规模占比超过80%。集成电路根据产品类别大致分为逻辑电路、存储器、模拟电路和微处理器四大类别。而按照生产制造的流程,集成电路行业可以分为集成电路设计、晶圆制造和封装测试三大组成部分。按照行业界的一般标准,半导体材料通常指的是晶圆制造和封装测试过程中所需的材料。

半导体材料行业概况

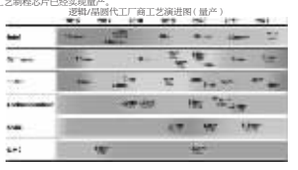


资料来源:根据SEMI资料整理

(2)行业发展阶段

集成电路产业按照摩尔定律持续发展,制程节点不断缩小、芯片的制程就是用来表征集成电路尺寸大小的一个参数,随着摩尔定律的发展,集成电路制程节点从1971年10微米一直发展到现在的10纳米,7纳米,5纳米。

逻辑芯片方面,各厂商制造工艺基本由制程节点所决定。从逻辑芯片制造最先进技术节点来看,目前台积电处于国际领先地位。中芯国际是国内领先的代工厂,目前14nm工艺制程芯片已经实现量产。



存储芯片方面,以NAND Flash和DRAM为主,两者合计占到了存储芯片超过96%的份额,存储芯片是一个高度垄断的市场,三星、SK海力士、美光、合计占据全球DRAM市场96%左右的份额,三星、SK海力士、美光、合计占据全球NAND市场95%左右的份额。目前,公司在这两大细分市场均有产品布局。

存储芯片行业属于技术密集型产业,中国存储芯片行业起步较晚,与国外存储芯片制造商相比仍存在一定差距。中国本土长江存储、合肥长鑫和福建晋华三大存储芯片公司已逐步完善NAND和DRAM产业布局,缩小与国外存储芯片制造商的差距。以3D NAND存储技术为例,长江存储(YMTC)2018年发布突破性技术Xtacking?,该技术为3D NAND闪存带来新的未来的闪存结构,更高的存储密度以及更短的产品上市周期。长江存储已成功将Xtacking?技术应用于其第二代3D NAND产品的开发,2020年推出128层3D NAND闪存。

NAND Flash大厂技术路产制程

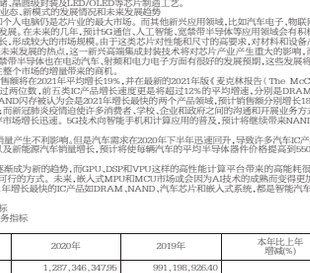
资料来源:TrendForce

随着半导体技术不断演进,进入“超越摩尔”时代,半导体大厂的发展重点逐渐从过去着力于晶圆制造工艺技术节点的推进,转向系统级设计制造封装技术的创新,先进封装在整个半导体产业链中的重要性将越来越突出,更将成为后摩尔时代半导体技术的重要发展新标。先进封装主要是指倒装、晶圆级封装、2.5D封装、3D封装等封装技术。全球封装市场规模以及增长率方面,根据Yole,2019年全球封装市场规模约为806亿美元,同比增长2%,市场规模稳步增长。而在这其中,先进封装市场规模以及增长率方面,根据Yole,2019年全球先进封装市场规模约为94亿美元,同比增长12%,2020年全球先进封装市场规模预计将达到390亿美元。

目前,公司在封装方面,公司积极从事晶圆级封装(WLP)的研发工作,并且上线使用后会通过较长周期逐步上量。

第四,稳定性高。正是因为封测环节要求较长的过程才能修真正实现制作,并且这个过程中客户的成本同样很高,所以在这个过程中客户的稳定性是非常重要的。

全球半导体设备市场及半导体材料市场规模变化趋势



资料来源:根据SEMI、WSTS数据整理

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和光刻胶去除剂的垄断,实现了进口替代,使中国在该领域拥有了自主供应能力。公司经过多年以来的技术积累和研发,品牌建设、优质社会评价及产品品质、管理和服务等方面的优势,在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。目前在国内,公司已成功化学机械抛光液领域主流的供应商,并与领先用户紧密合作共同开发行业技术领先制程专用产品,根据SEMI最新的报告整理,公司CMP抛光液在全球市场的份额由2019年的3%左右成长到2020年的4.5%左右。在光刻胶去除剂板块,公司致力于先进制程用技术及产品开发,已成为技术领先的本土供应商,产品广泛用于逻辑、存储、扁平显示封装及LED/OLED等领域的国内主流。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期及过去的几年内,手机和个人电脑仍是芯片业的最大市场。而其他新兴应用领域,比如汽车电子、物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和机器人等也有了积极的发展。在未来的几年,预计5G通信、人工智能、高性能半导体等应用领域会有积极的增长,尤其是5G通信市场,预计在未来的几年内会成为公司主要的增长点。

(a)“新”。集成电路产业能够延续摩尔定律不断发展,离不开半导体材料性能改善和新材料的应用,为了提高集成电路的性能,集成电路制造商逐步增加每块集成电路上电子元器件与传线路的数量和密度并不断引进新的介质和导电材料,这增加了集成电路的复杂性和对CMP抛光材料尤其是起着最关键作用的抛光液的相关需求。在“高”方面,在从微米到纳米级别的器件线路上,对高端制程的关除速率、选择比及表面粗糙度和缺陷都要求精准至纳米为至埃(分子级)。如此精准的控制要求通过精密、多种类的化学机械抛光和抛光后清洗的制程步骤来实现。在“快”方面,随着芯片的集成度不断提高,在14纳米、10纳米、7纳米、5纳米等更先进的制程节点,CMP工艺将面临各种高难度的挑战,对抛光材料尤其是抛光液将提出前所未有的高难度技术要求。

(b)“多”。在逻辑芯片、存储芯片等集成电路技术不断推进过程中,对抛光材料,尤其是抛光液的需求出现了“多”的趋势和特征,客户和供应商联合开发成为成功的先决条件。即使是同一技术节点,不同客户的集成技术不同,对抛光液的需求也不同。

(c)“多”。在集成电路技术不断推进过程中,必然出现多种新技术和新材料,这些新技术和新材料对抛光工艺材料提出了许多新的要求。随着集成电路技术的进步和对集成电路性能要求的增加,下游客户在制造过程中使用CMP工艺的集成电路比例在不断增加对以CMP抛光液为主的材料种类和用量的需求也在增加。更先进的逻辑芯片工艺可能会出现的器件材料需要抛光工艺,为CMP抛光液带来了更多的增长机会,比如14纳米以下逻辑芯片工艺要求的关键CMP工艺将达到20步以上,使用的抛光液将从90纳米的五六种抛光液增加到二十种以上,种类和用量迅速增长;7纳米及以下逻辑芯片工艺中CMP抛光步骤甚至可能达到30步,使用的抛光液种类预计将达到二十种。同样地,存储芯片由2D NAND向3D NAND技术变革,也会使CMP抛光步骤数量成倍翻番。

消费端涉及表面科学、流体力学、电化学、材料化学、机械学等交叉学科。在产品配方方面,公司积极入局基于对光刻胶性质原理的理解,在光刻胶去除剂的研发、生产、测试、检验分析等流程中产品配方,并通过申请专利等方式加以保护。在生产工艺流程方面,通过各种工艺参数的设计、研究和实验等方式来确定生产工艺路线,形成公司技术秘密予以保护。特别是集成电路领域高端光刻胶去除剂,鉴于其图形尺寸只有纳米级,对产品配方及生产工艺流程控制要求更高,目前国内仅有极少数供应商具有供应能力。

(4)行业基本特点

半导体材料行业不仅技术门槛高,也是一个产业规模大、细分行业多,同时投入大、见效慢、周期长、但稳定性高的行业。

第一,产业规模大。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料,根据SEMI的最新报告,2020年全球半导体材料销售额预计为563亿美元,相较于2019年增长4.3%,其中,中国台湾地区规模最大,达到129亿美元,增长率也达到最高,一中国大陆市场规模紧随其后为550美元以上,这也将极大地提升车载IC市场收入。

在目前的A股域,边缘学习将逐渐成为新的趋势,而GPU、DSP和VPU这样的高性能计算平台带来的高能耗很难在本地进行,对已有的微处理器和微控制器的构架进行升级就成为了一个可行的方式。未来,嵌入式MPU和MCU市场或会因为A技术的成熟而受惠加重,为IC产品的增长提供了保障。

目前IC Insights预测将在2021年增长最快的IC产品如DRAM、NAND、汽车芯片和嵌入式系统,都是智能产品、5G技术、云计算、物联网和AI领域等新兴领域最核心的技术产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,287,346,347.95	991,198,926.40	29.88	433,314,562.26
营业收入	422,379,914.29	285,410,172.10	47.99	247,848,714.83
归属于上市公司股东的净利润	153,989,118.92	65,846,041.18	133.86	44,962,447.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,850,726.56	43,031,261.59	36.76	43,129,761.73
归属于上市公司股东的净资产	1,048,104,787.27	887,569,640.68	18.09	346,757,773.40
经营活动产生的现金流量净额	113,173,725.28	84,622,099.91	33.65	59,763,009.36
基本每股收益(元/股)	2.90	1.45	100.00	1.13
稀释每股收益(元/股)	2.90	1.45	100.00	1.13
加权平均净资产收益率(%)	15.94	11.40	增加4.54个百分点	13.87
研发投入占营业收入的比例(%)	21.05	20.16	增加0.89个百分点	21.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	96,338,088.07	95,403,921.06	116,963,508.03	113,674,397.13
归属于上市公司股东的净利润	23,556,378.57	26,246,085.83	63,801,805.25	40,384,849.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,734,941.39	26,262,992.8	15,999,301.1	-6,146,508.73
经营活动产生的现金流量净额	-3,233,327.18	26,520,366.82	8,230,144.66	81,656,540.98

注:根据2021年2月6日财会〔2021〕2号通知,公司报告期内购买的结构性存款产生的利息过计入投资收益或公允价值变动损益,公司于第四季度将全年的利息收入从财务费用调整至投资收益和公允价值变动损益。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,004
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,654
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
Anji Microelectronics Co., Ltd.	0	22,560,328	42.48	22,560,328	0	无	0	其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	6,144,572	11.57	0	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	2,445,849	2,500,227	4.71	0	0	无	0	其他
上海张江科技创业投资有限公司	-1,378,464	2,170,271	4.09	0	0	无	0	国有法人
上海大辰科技投资有限公司	-500,000	1,900,028	3.58	0	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,037,506	1,037,506	1.95	0	0	无	0	其他
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	-1,420,973	893,536	1.68	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	547,175	547,175	1.03	0	0	无	0	其他
中银万国创新证券投资有限公司(注)	461,700	483,765	0.91			无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	474,376	474,376	0.89	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

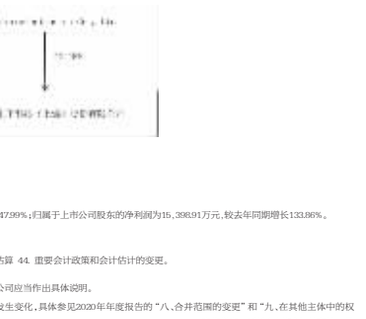
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

√适用 □不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入42,237.99万元,比去年同期增长47.99%;归属于上市公司股东的净利润为15,398.91万元,较去年同期增长133.86%。

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详情请见本年报第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估算 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计3家,本期合并范围未发生变化,具体参见2020年年度报告的“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

安集微电子科技(上海)股份有限公司

法定代表人:Shumin Wang

2021年3月30日

公司代码:688019 公司简称:安集科技

安集微电子科技(上海)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2021-007

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2021年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,公司于2021年3月19日以邮件方式向全体董事发出了会议的通知,与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持,会议应出席董事9名,实际董事9名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手投票方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2020年度,公司董事会本着对全体股东负责的精神,按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求,谨慎、认真地履行自身职责,按时召开股东大会并认真执行股东大会决议,切实维护公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。公司监事会同意通过此报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现营业收入42,237.99万元,比去年同期增长47.99%;实现归属于上市公司股东的净利润为15,398.91万元,较去年同期增长133.86%。公司2020年年度报告内容及格式符合相关法律法规及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的编制要求,公司财务状况、经营成果等情况在2020年年度报告中进行了真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司以实施2020年度分红派息权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为53,108,380股,以此计算合计拟派发现金红利总额为15,932,514.00元(含税),占母公司当年实现可分配利润比例的11.01%,占公司合并报表归属上市公司股东净利润的10.35%,剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年度利润分配方案公告》(2021-009)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

董事会同意公司编制的《2020年度董事会工作报告》,该报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

经审核,董事会认为公司编制的《2020年度独立董事述职报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内,公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》等有关规定,充分利用专业知识、履职精神、客观、独立的原则,勤勉尽责、有分别地对公司财务状况、内部控制、重大事项等进行了有效的监督和建议,切实维护公司和股东的利益。公司董事会认为公司审计委员会在2020年度履职过程中,未发现公司存在与审计委员会的监督职能、应履行的职责相违背的情形,尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》

2020年末,公司总资产为129,734,637万元,较年初增加28.01%;归属于上市公司股东的净资产为104,810.48万元,较年初增加18.09%。报告期内,公司实现营业收入42,237.99万元,比去年同期增长47.99%;归属于上市公司股东的净利润为15,398.91万元,较去年同期增长133.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,850.72万元,比去年同期增长36.76%。

根据公司的2021年经营计划,公司将持续加强技术创新,加大研发投入,加强产业链上下游合作,加强能力建设,实现经营利润的稳步增长的同时兼顾长期业务发展机会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司以实施2020年度分红派息权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为53,108,380股,以此计算合计拟派发现金红利总额为15,932,514.00元(含税),占母公司当年实现可分配利润比例的11.01%,占公司合并报表归属上市公司股东净利润的10.35%,剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年度利润分配方案公告》(2021-009)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2020年度董事会会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据财政部颁布的最新会计准则,对公司会计政策进行变更,并根据《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司日常信息披露指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等有关规定,以及公司《信息披露管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

特此报告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2021-008

安集微电子科技(上海)股份有限公司2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每10股派发现金红利3.00元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%,是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为153,989,118.92元,母公司实现的净利润为159,224,066.06元,提取法定盈余公积后,2020年当年实际可供股东分配利润为144,749,356.60元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为53,108,380股,以此计算合计拟派发现金红利15,932,514.00元(含税)。本年度公司现金分红占母公司当年实现可分配利润比例的11.01%,占公司合并报表归属上市公司股东净利润的10.35%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东净利润为153,989,118.92元,母公司累计未分配利润为229,879,978.92元,上市公司拟分配的现金红利总额为15,932,514.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分析如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和光刻胶去除剂的垄断,实现了进口替代,使中国在该领域拥有了自主供应能力。

在化学机械抛光液板块,公司积极加强并全面对接全品类产品线的布局,旨在为客户提供完整的一站式解决方案。一方面,公司化学机械抛光液包括硅抛光液、钨抛光液(STI)抛光液、介质层抛光液、铝抛光液、铜以及铜阻挡层抛光液、硅通孔(TSV)抛光液和基于氧化铈磨料的抛光液等系列产品。另一方面,抛光后清洗液是化学机械抛光工艺过程中处理颗粒污染物的关键材料,包括铜制程抛光后清洗液、钨制程抛光后清洗液以及抛光垫清洗液等系列产品。同时,公司还基于化学机械抛光液技术和产品平台,支持客户对于不同制程的需求,定制研发用于新技术新工艺的化学机械抛光液。公司产品已供应国内外多家逻辑芯片和存储芯片制造商,并成为国内主流的抛光液供应商。公司化学机械抛光液已成功用于130-14nm逻辑芯片工艺、存储芯片工艺和三维集成工艺,10-7nm技术节点产品正在研发中。

在光刻胶去除剂板块,公司专注聚焦于全品类光刻胶去除不方点最关并提供相应的产品和解决方案。根据光刻胶下游应用领域不同,公司光刻胶去除剂包括集成电路制造用、扁平显示封装用、LED/OLED用等系列产品。

(二)主要经营模式

1.采购模式

公司制定了《采购管理程序》和采购管理内部控制流程,并制定了《采购流程》、《供应商管理流程》、《供应灾难恢复程序》等标准作业程序。

(1)一般采购流程

以原、辅材料和包装材料为例,公司的一般采购主要流程如下:

①技术研发部根出材料开发需求,采购部负责开发供应商,并由供应商管理小组负责材料评估、供应商认证、审核、导入及批准为公司合格供应商,采购部负责建立并维护《合格供应商目录》。公司供应商管理小组由采购部、技术研发部、质量部、生产运营部等部门人员组成。

②需求部门提出采购申请,并按照公司审批权限得到合适的批准后提交采购部,采购部负责管理订单执行,质量部负责采购来料检验管理,仓库负责采购入库管理。

③采购部根据采购合同/订单,获取发票,并整理入库及验收等付款凭证提交财务部申请付款并得到审批。

④财务部根据采购合同/订单约定负责采购付款管理。

(2)外协采购流程

报告期内,公司产品LED/OLED用光刻胶去除剂存在委托外协供应商生产的情形,即公司与外协供应商签订协议,外协供应商严格按照公司提供的工艺文件、技术标准采组织生产,进行质量管理控制。公司所有的产品配方、生产工艺、任何发明、设计、技术信息、技术、专有技术或者由公司依协议授权外协供应商使用的商标、商业秘密及其他知识产权属于公司所有并独有。公司的外协采购主要流程如下:

①生产运营部根据月度销售预测生成外协采购申请单;

②采购部根据外协采购申请单下订单;

③外协供应商按订单要求安排生产;

④财务部每月末进行外协采购成本核算。

2.研发模式

公司始终围绕自身的核心技术,以自主研发为主,形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制。同时,公司与高校、客户等外部单位建立了良好的合作关系,积极开展多层次、多方式的合作研发。公司的研发目标一方面表现随行业发展的技术发展路线图,研发适应产业需求的产品平台;另一方面表基于下游客户的需求,针对性研发满足客户需求的产品。由于从开始研发到实现规模化销售需要较长的时间,公司与技术新先的客户合作开发,有助于了解客户需求并为其开发创新性的解决方案。

公司制定了《研发管理制度》,并建立了研发管理内部控制流程,涵盖研发计划、研发立项、研发过程跟进和费用核算管理、专利申请和取得等环节。公司产品研发及产业化的一般路径主要包括项目论证、研发Alpha测试、Beta送样试生产、商业化(规模化生产)、持续改进等五个阶段。

3.生产模式

公司在产品设计及研发前期,即投入大量资源与下游客户进行技术、品质、性能交流。当产品通过客户评价和测试后,销售部会根据客户的产品订单及对于客户使用需求的预测制定滚动出货预期,生产运营部根据年度/月度生产计划,滚动出货预期和库存情况制订具体的生产计划,安排所存、具体而言,生产运营部每年组织各相关部门,根据排产计划编制年度生产计划及月度生产计划。生产运营部会定期进行集体评审,根据每月存货存量、滚动出货预测制定具体的生产计划,以确保生产计划满足销售合同以及生产产能的要求;生产运营部组织各相关部门,各产品线负责人召开生产调度会,对生产计划的执行情况进行评审,以确保充分沟通可能影响生产计划变更的各种因素,及时调整生产计划(如及时关闭停工订单),以确保计划调整的及时性及有效性。

公司已经掌握了化学机械抛光液和光刻胶去除剂生产中的核心技术,通过合理调配机器设备和生产资源相